## 05.3 Усиление сигнала при стохастическом резонансе в пленке диоксида ванадия

## © В.Ш. Алиев, С.Г. Бортников, М.А. Демьяненко

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск E-mail: aliev@isp.nsc.ru

## Поступило в Редакцию 18 апреля 2012 г.

В планарной структуре с VO<sub>2</sub> проводящим каналом, включенной последовательно с нагрузочным резистором, наблюдалось явление стохастического резонанса с усилением входного сигнала в 1.6 раза. Коэффициент передачи отношения сигнал-шум в схеме достигал 250.

Известно, что стохастический резонанс (СР) является одним из примеров индуцированных шумом переходов в нелинейных системах, возбуждаемых одновременно информационным сигналом и шумом [1]. При определенном подборе уровня шума на входе нелинейной системы в условиях стохастического резонанса наблюдается улучшение такой важной характеристики информационного сигнала, как отношение сигнал-шум и даже усиление сигнала. Представляет интерес исследование этого явления в пленках диоксида ванадия, которые, с одной стороны, проявляют ярко выраженные нелинейные электрофизические свойства вблизи фазового перехода металл-полупроводник (МП) [2], а с другой — широко используются в качестве чувствительного слоя болометров для регистрации и визуализации ИК-излучения [3,4]. Очевидно, что прямое использование СР в обычных болометрических матрицах из-за схемотехнической концепции построения системы регистрации сигнала, скорее всего, не даст положительного эффекта. Однако в системах регистрации, построенных по подобию биологических систем, использование СР может оказаться эффективным. Первое наблюдение СР в пленках диоксида ванадия было продемонстрировано в работе [5], в которой пленка играла роль многовходового компаратора для выделения сигнала на фоне шума и помех. В данной работе путем электроформовки была сформирована планарная структура с VO<sub>2</sub> проводящим каналом. В схеме, состоящей из данной структуры

13

и последовательно включенного с ней резистора, было обнаружено явление СР с усилением входного сигнала.

В работе для выращивания пленок оксидов ванадия был использован метод ионно-лучевого распыления—осаждения. В качестве мишени для распыления использовался металлический ванадий (марка МнВ-1, V > 99.5%). Распыление проводилось в присутствии кислорода (ОСЧ,  $O_2 > 99.998\%$ ), который подавался в вакуумную камеру, откачиваемую криогенным насосом. Остаточное давление в камере не превышало  $7 \cdot 10^{-5}$  Ра. В качестве подложек были использованы пластинки кремния, покрытые термическим SiO<sub>2</sub>. Температура подложки при нанесении пленок составляла 723 K, а скорость осаждения — 0.034 nm/s. Выращивались пленки толщиной около 150 nm.

Структурные исследования, проведенные методом дифракции быстрых электронов на приборе EF-Z4 при ускоряющем напряжении 50 keV, показали, что выращенные пленки являлись поликристаллическими, состоящими из смеси двух кристаллических фаз —  $VO_2$  и  $V_6O_{13}$  и аморфной фазы.

По данным эллипсометрии (ЛЭФ-3М, длина волны света 632.8 nm) толщина одной из выращенных пленок составила  $181.0 \pm 6.9$  mm, показатель преломления  $n = 1.665 \pm 0.044$  и коэффициент поглощения  $k = 0.07 \pm 0.01$ . Слоевое сопротивление данной пленки, измеренное четырехзондовым методом, было равно  $235 k\Omega$  square.

Электрические измерения были выполнены на структурах, изготовленных методом фотолитографии. Сечение структуры показано на рис. 1, *а*. Зазор между контактами был равен 3  $\mu$ m, а ширина контактной области на мезе — 50  $\mu$ m. Контакты отжигались в кварцевом трубном реакторе в потоке аргона высокой чистоты (Ar > 99.999%) при температуре 523 К в течение 30 min. Слоевое сопротивление пленки после отжига практически не изменилось.

При нагреве от комнатной температуры (296 К) до температуры 353 К сопротивление структуры уменьшалось всего в 4.7 раза. Учитывая, что пленка состояла из смеси фаз, было сделано предположение, что между металлическими электродами (рис. 1, a) отсутствовал канал проводимости по нанокристаллам VO<sub>2</sub>. Для создания проводящего канала была использована электроформовка [6]. Для этого на образец кратковременно подавалось напряжение около 20–30 V через ограничивающее сопротивление. В результате в пленке оксидов ванадия образовывался "проводящий" канал шириной около 2 $\mu$ m, который был



**Рис. 1.** Электрическая схема для наблюдения СР в структуре с VO<sub>2</sub> проводящим каналом. Резисторы:  $R_1 = 100\Omega$  — входной,  $R_2 = 1.05 k\Omega$  — выходной. a — схематическое изображение сечения структуры,  $R_x$  — сопротивление структуры; b — АСМ-изображение проводящего канала, образовавшегося в результате электроформовки; c — ВАХ структуры с проводящим каналом при различных температурах.

визуализирован методом атомно-силовой микроскопии (AC) (SOLVER P-4, NT-MDT) (рис. 1, *b*). Формовка изменила сопротивление структуры с 13.4 до 17.3 k $\Omega$ . После формовки сопротивление структуры при нагреве от комнатной температуры до температуры 353 К уменьшалось уже в 40.3 раза. ВАХ формованной структуры, снятые при разных температурах на характериографе TR-4805 с внутренним ограничивающим сопротивлением 1 k $\Omega$ , показаны на рис. 1, *c*. После формовки ВАХ структур оставались стабильными в течение всего времени измерений (несколько часов), а также воспроизводились на следующий день.

Из ширины электрода (50  $\mu$ m), ширины канала (2  $\mu$ m) и величин сопротивления отформованной структуры были оценены сопротивления канала при комнатной температуре и при температуре 353 К, которые оказались равными 432.5 kΩ и 429 Ω соответственно. Столь значительное (на три порядка) изменение сопротивления канала в области температур от 296 до 353 К позволяет сделать предположение о том, что в канале после формовки фазовый состав пленки изменился до VO<sub>2</sub>, для которого существует фазовый переход МП при температуре 341 К.

Электрическая схема, в которой наблюдался СР, показана на рис. 1. Путем пропускания через R1 постоянного тока от источника Ib задавалось рабочее напряжение на структуре без подачи сигнала и шума. Источники тока Is и In являлись источниками сигнала и шума соответственно. Сигнал представлял собой импульсы длительностью  $\tau = 1$  ms, следующие с частотой 100 Hz. Источник шума генерировал белый шум в полосе 10 Hz - 600 kHz. На входном сопротивлении R1 суммировались: постоянное напряжение смещения, сигнал и шум. Входное U1 и выходное U2 напряжения записывалсь цифровым осциллографом GDS-2202 (GW INSTEK).

На рис. 2 показаны осциллограммы U1 и U2 при разных мощностях шума (D) на входе схемы для отформованной структуры с  $R_x = 22.8$  kΩ. Видно, что с ростом мощности шума сигнал становился незаметным в осциллограммах U1 и U2 (рис. 2, b). При мощности шума около 0.15 mW появлялись отдельные импульсы, сивдетельствующие о случайных перескоках пленки VO<sub>2</sub> из высокоомного в низкоомное состояние. И при мощности шума 0.29 mW импульсы на выходе схемы по частоте и фазе совпадали с входными импульсами (рис. 2, c). При дальнейшем увеличении мощности шума количество выходных имульсов начинало превышать количество входных импульсов.



**Рис. 2.** Осциллограммы U1 и U2 при различных мощностях шума (D) на входном резисторе R1: a = 0.011 mW; b = 0.092 mW; c = 0.29 mW.



Из осциллограмм U1 и U2 были рассчитаны отношения сигнал-шум на входе (RSN1) и выходе (RSN2) схемы. При расчете были использованы осциллограммы, охватывающие временной интервал, содержащий m = 14 импульсов сигнала. Расчет RSN1 представлен ниже:

$$RSN\,1=\frac{(U1s)^2}{(U1n)^2},$$

$$(U1n)^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{1}{T-\tau} \int_{t_{j+\tau}}^{t_{j+1}} (U1(t) - \tilde{U}1)^2 dt,$$

$$\tilde{U}1 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} \frac{1}{T - \tau} \int_{t_{j+\tau}}^{t_{j+1}} U1(t) dt$$

$$(U1s)^2 = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \frac{1}{\tau} \int_{t_j}^{t_{j+\tau}} ((U1(t) - \tilde{U}1)^2 - (U1n)^2) dt$$

где  $(U1n)^2$ ) — квадрат напряжения шума на входном резисторе *R*1, рассчитанный по осциллограмме U1(t) во временном интервале  $(t_j + \tau, t_{j+1})$ , где нет импульсов;  $\tilde{U}1$  — постоянное напряжение на резисторе *R*1, рассчитанное путем усреднения U1(t) во временном интервале, где нет имульсов;  $(U1s)^2$  — квадрат напряжения сигнала на входном резисторе *R*1, рассчитанный по осциллограмме U1(t) во временном интервале  $(t_j, t_j + \tau)$ , где есть импульсы; t — текущее время;  $t_j$  — начало *j*-го импульса;  $\tau = 1$  ms — длительность импульса; T = 10 ms — период следования импульсов. Аналогично было рассчитано *RSN*2. Изменяя мощность источника шума и рассчитывая входную мощность шума как  $D = (U1n)^2/R1$ , были получены зависимости RSN1(D) и RSN2(D) (рис. 3).

Отношение сигнал-шум на выходе схемы RSN2(D) на начальном участке спадает по линейному закону, так же как RSN1(D), однако в области мощностей шума 0.1-1.0 mW наблюдается резкий рост зависимости RSN2(D), а затем ее спад. Такое поведение зависимости отношения сигнал-шум от внешне вводимого в систему шума характерно для явления стохастического резонанса [1]. В максимуме зависимости RSN2(D) величина отношения сигнал-шум на выходе схемы была в 250 раз больше отношения сигнал-шум на входе, а амплитуда сигнала на выходе — в 1.6 раз выше амплитуды сигнала на входе, т.е. в схеме, состоящей только из пассивных элементов, при СР наблюдалось усиление сигнала.

Интересно отметить, что зависимость RSN2(D) хорошо описывается функцией  $y(x) = -x + 1.6 \cdot F(x, m, \sigma)$ , где  $x = 2.2 + \lg(D)$ ,  $F(x, m, \sigma)$  — функция логарифмически-нормального распределения (ЛНР) с математическим ожиданием m = -0.4 и дисперсией  $\sigma = 0.4$ . Хорошая аппроксимация зависимости RSN2(D) функцией ЛНР указывает на то, что отклик нелинейной системы является мультипликативным по отношению к источникам сигнала и шума. Отчасти это объясняет наблюдаемый аномально высокий коэффициент передачи отношения сигнал-шум. Действительно, гармонические составляющие сигнала и шума взаимодействуют посредством теплового эффекта в ограниченном пространстве  $(2\mu m \times 3\mu m \times 0.1 \text{ nm})$  проводящего канала, состояще-



**Рис. 3.** Зависимость отношения сигнал-шум на входе RSN1(D) и на выходе RSN2(D) схемы от мощности входного шума: 1 — линейная аппроксимация зависимости RSN1(D), 2 — аппроксимация зависимости RSN2(D) функцией логарифмически-нормального распределения.

го из пленки VO<sub>2</sub>, которая обладает в области фазового перехода аномально высоким температурным коэффициентом сопротивления, достигающим 34%/К [7]. Очевидно, для яркого проявления СР структура должна "попасть" в узкую температурную область фазового перехода (10 K). Рабочая точка структуры задавалась в экспериментах источником постоянного тока *Ib*. Однако экспериментально наблюдалась самопроизвольная подстройка рабочей точки структуры при переходе в режим СР. Из осциллограмм U2 (рис. 2) видно, что при увеличении мощности шума и возникновении СР происходит сдвиг базовой линии осциллограммы, что соответствует увеличению среднего тока, протекающего через структуру. Это означает, что в условиях СР наблюдается автоподстройка рабочей точки структуры по постоянному

току. Новая рабочая точка структуры, по-видимому, сдвигает локальную среднюю температуру проводящего канала в область фазового перехода МП, что обеспечивает максимальную эффективность взаимодействия гармонических составляющих сигнала и шума.

## Список литературы

- [1] Анищенко В.С. и др. // УФН. 1999. Т. 169. В. 1. С. 7.
- [2] Мотт Н.Ф. // Переходы металл-изолятор. М.: Наука, 1979. С. 342.
- [3] de Almeida L.A.L. et al. // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 94. P. 3605.
- [4] Демьяненко М.А. и др. // Вестник НГУ. Сер. Физ. 2010. Т. 5. В. 4. С. 73.
- [5] Kanki T. et al. // Appl. Phys. Lett. 2010. V. 96. P. 242 108.
- [6] Стефанович Г.Б. и др. // Письма в ЖТФ. 2000. Т. 26. В. 11. С. 62.
- [7] *Алиев В.Ш.* и др. // Труды 12-й Междунар. конференции и семинара EDM'2011. Эрлагол, Алтай, 2011. С. 129.